

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 2 部門第 6 区分
【発行日】平成 17 年 5 月 12 日 (2005.5.12)

【公表番号】特表 2001-500457(P2001-500457A)
【公表日】平成 13 年 1 月 16 日 (2001.1.16)
【出願番号】特願平 10-513858
【国際特許分類第 7 版】
B 6 5 D 73/02
【F I】
B 6 5 D 73/02 K

【手続補正書】
【提出日】平成 16 年 9 月 13 日 (2004.9.13)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】補正の内容のとおり
【補正方法】変更
【補正の内容】

手 続 補 正 書

平成16年 9月13日

特許庁長官 殿



1. 事件の表示

平成10年特許願第513858号

2. 補正をする者

名 称 ネプトコ・インコーポレーテッド

3. 代 理 人

住 所 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル206区
ユアサハラ法律特許事務所

電 話 3270-6641~6

ファクシミリ 3246-0233

氏 名 (8970) 弁理士 社 本 一 夫

住 所 同 所

担当者氏名 (9371) 弁理士 神 田 藤 博



4. 補正対象書類名

明細書

請求の範囲

5. 補正対象項目名

明細書

請求の範囲



6. 補正の内容

別紙の通り

審査



(別 紙)

(1) 請求の範囲の記載を下記の通りに訂正する。

『1. 装置であって、

区画室 (18, 96) を有する担体テープ (14, 90) を備えており、前記区画室の各々は、所定の幅を有しており、前記担体テープの長手方向に間欠的に設けられており、

前記装置は、また、

前記区画室内の品物を封止するための、前記担体テープに設けられたカバーテープ (12, 120) を備えており、

前記カバーテープは、

第1の面と、第2の面と、幅とを有するベースフィルム層 (50, 70, 122) と、

前記ベースフィルム層の前記第1の面に形成されたストライプ状の接着剤層 (64, 84, 134, 140) と、

前記ベースフィルム層の前記第1の面のほぼ全体の幅に帯電防止コーティングが設けられるように、前記ストライプ状の接着剤層と前記ベースフィルム層とに形成された第1の帯電防止層 (66) とを備えており、

前記ストライプ状の接着剤層によって、前記カバーテープが前記担体テープに接着されている装置。

2. 請求項1に記載の装置において、

前記ストライプ状の接着剤層は、製品目視領域 (56, 142) を画定する複数の接着剤ストライプ (64, 84, 134, 140) を備えており、前記製品目視領域 (56, 142) は、約1%の反射率を備えている装置。

3. 請求項1に記載の装置において、

さらに、前記ベースフィルム層の第2の層に形成された第2の帯電防止層 (68, 86, 136) を備えている装置。

4. 請求項1に記載の装置において、

前記ストライプ状の接着剤層は、製品目視領域 (56, 142) を画定する複数の接着剤ストライプ (64, 84, 134, 140) を備えている装置。

5. 請求項4に記載の装置において、

前記複数の接着剤ストライプ (64, 84, 134, 140) は、少なくとも前記担体テープ区画室の幅の距離だけ互いに隔置されている装置。

6. 請求項1に記載の装置において、

前記ベースフィルム層 (50, 70, 122) は、前記第1の面に被覆された下地材層を備えている装置。

7. 請求項1に記載の装置において、

前記ストライプ状の接着剤層は、前記接着剤層に分配された充填材料を備えている装置。

8. 請求項1に記載の装置において、

前記ベースフィルム層の前記第1の面は、中央領域を画定する一対のエッジ領域 (52, 54, 76, 78, 106) を備えている装置。

9. 請求項8に記載の装置において、

前記担体テープは、さらに、複数の横方向に隔置された区画室 (96) を備えている装置。

10. 請求項9に記載の装置において、

前記ストライプ状の接着剤層 (134, 140) は、製品目視領域 (142) を画定する複数の接着剤ストライプを備えている装置。

11. 請求項10に記載の装置において、

前記複数の接着剤ストライプ (134, 140) は、少なくとも前記横方向に隔置された担体テープ区画室 (96) の幅の距離だけ互いに隔置されている装置。

。

12. 請求項11に記載の装置において、

前記複数の接着剤ストライプは、前記エッジ領域に位置決めされた一対のエッジストライプ (134) と、前記中央領域に位置決めされた少なくとも1つのブリッジストライプ (140) とを備えている装置。

13. 請求項9に記載の装置において、

前記ベースフィルム層 (122) は、前記第1の面に被覆された下地材層 (128) を備えている装置。

1 4. 請求項9に記載の装置において、

前記ストライプが被覆された接着剤層 (6 4, 8 4, 1 3 4, 1 4 0) は、前記接着剤層に分散させられた充填材料を備えている装置。

1 5. 請求項9に記載の装置において、

さらに、前記ベースフィルム層の前記第2の面に形成された第2の帯電防止層 (6 8, 8 6, 1 3 6) を備えている装置。

1 6. 装置であって、

区画室 (1 8, 9 6) を有する担体テープ (1 4, 9 0) を備えており、前記区画室の各々は、所定の幅を有しており、前記担体テープの長手方向に間欠的に設けられており、

前記装置は、また、

前記区画室内の品物を封止するための、前記担体テープに設けられたカバーテープ (1 2, 1 2 0) を備えており、

前記カバーテープは、

第1の面と、第2の面と、幅とを有するベースフィルム層 (5 0, 7 0, 1 2 2) と、

前記ベースフィルム層の前記第1の面に被覆された下地材層 (6 2, 8 2, 1 2 8) とを備えており、前記下地材層は、帯電防止物質を含んでおり、それによって、前記帯電防止保護部分が、前記ベースフィルムの第1の面のほぼ全体の幅に設けられており、

前記装置は、また、

前記下地材層に形成されたストライプ状の接着剤層 (6 4, 8 4, 1 3 4, 1 4 0) を備えており、前記ストライプ状の接着剤層によって、前記カバーテープが前記担体テープに接着される装置。

1 7. 請求項1 6に記載の装置において、

さらに、前記ベースフィルム層の第2の層に形成された帯電防止層 (6 8, 8 6, 1 3 6) を備えている装置。

1 8. 請求項1 6に記載の装置において、

前記ストライプ状の接着剤層は、製品目視領域 (5 6, 1 4 2) を画定する複

数の接着剤ストライプ (6 4, 8 4, 1 3 4, 1 4 0) を備えている装置。

1 9．請求項 1 8 に記載の装置において、

前記複数の接着剤ストライプ (6 4, 8 4, 1 3 4, 1 4 0) は、少なくとも前記担体テープ区画室の幅の距離だけ互いに隔置されている装置。

2 0．請求項 1 6 に記載の装置において、

前記ストライプ状の接着剤層は、前記接着剤層に分配された充填材料を備えている装置。

2 1．請求項 1 6 に記載の装置において、

前記ベースフィルム層の前記第 1 の面は、中央領域を画定する一対のエッジ領域 (5 2, 5 4, 7 6, 7 8, 1 0 6) を備えている装置。

2 2．請求項 2 1 に記載の装置において、

前記担体テープは、さらに、複数の横方向に互いに隔置された区画室 (9 6) を備えている装置。

2 3．請求項 2 2 に記載の装置において、

前記ストライプ状の接着剤層は、製品目視領域 (1 4 2) を画定する複数の接着剤ストライプ (1 3 4, 1 4 0) を備えている装置。

2 4．請求項 2 3 に記載の装置において、

前記複数の接着剤ストライプ (1 3 4, 1 4 0) は、少なくとも前記横方向に分離された担体テープ区画室 (9 6) の幅の距離だけ隔置されている装置。

2 5．請求項 2 4 に記載の装置において、

前記複数の接着剤ストライプは、前記エッジ領域に位置決めされた一対のエッジストライプ (1 3 4) と、前記中央領域に位置決めされた少なくとも 1 つのブリッジストライプ (1 4 0) とを備えている装置。

2 6．請求項 2 2 に記載の装置において、

前記ストライプ状の接着剤層 (1 3 4, 1 4 0) は、前記接着剤層に分散させられた充填材料を備えている装置。

2 7．請求項 2 2 に記載の装置において、

さらに、前記ベースフィルム層 (1 3 6) の前記第 2 の面に形成された帯電防止層を備えている装置。

28. 担体テープ(14, 90)の区画室に品物を封止するためのカバーテープ(12, 120)であって、

前記カバーテープは、

第1の面と、第2の面と、幅とを有するベースフィルム層(50, 70, 122)と、

前記ベースフィルム層の前記第1の面に形成されたストライプ状の接着剤層(64, 84, 134, 140)と、

前記ベースフィルム層の前記第1の面のほぼ全体の幅に帯電防止コーティングが設けられるように、前記ストライプ状の接着剤層と前記ベースフィルム層とに形成された第1の帯電防止層(66)とを備えたカバーテープ。

29. 請求項28に記載のカバーテープにおいて、

さらに、前記ベースフィルム層の第2の層に形成された第2の帯電防止層(68, 86, 136)を備えているカバーテープ。

30. 請求項28に記載のカバーテープにおいて、

前記ベースフィルム層の前記第1の面は、中央領域を画定する一対のエッジ領域(52, 54, 76, 78, 106)を備えているカバーテープ。

31. 請求項30に記載のカバーテープにおいて、

前記ストライプ状の接着剤層は、製品目視領域(56, 142)を画定する複数の接着剤ストライプ(64, 84, 134, 140)を備えているカバーテープ。

32. 請求項31に記載のカバーテープにおいて、

前記複数の接着剤ストライプ(64, 84, 134, 140)は、少なくとも前記担体テープ区画室の幅の距離だけ隔置されているカバーテープ。

33. 請求項32に記載のカバーテープにおいて、

前記複数の接着剤ストライプは、前記エッジ領域に位置決めされた一対のエッジストライプ(134)と、前記中央領域に位置決めされた少なくとも1つのブリッジストライプ(140)とを備えているカバーテープ。

34. 請求項28に記載のカバーテープにおいて、

前記ベースフィルム層(50, 70, 122)は、前記第1の面に被覆された

下地材層 (62, 82, 128) を備えているカバーテープ。

35. 請求項28に記載のカバーテープにおいて、

前記ストライプ状の接着剤層は、前記接着剤層に分配された充填材料を備えているカバーテープ。

36. 担体テープ (14, 90) の区画室に品物を封止するためのカバーテープ (12, 120) であって、

前記カバーテープは、

第1の面と、第2の面と、幅とを有するベースフィルム層 (50, 70, 122) と、

前記ベースフィルム層の前記第1の面に被覆された下地材層 (62, 82, 128) とを備えており、前記下地材層は、前記ベースフィルムの前記第1の面のほぼ全体の幅に帯電防止保護部分が設けられるように、帯電防止物質を含んでおり、

前記カバーテープは、また、

前記下地材層に形成されたストライプ状の接着剤層 (64, 84, 134, 140) を備えているカバーテープ。

37. 請求項36に記載のカバーテープにおいて、

さらに、前記ベースフィルム層の第2の面に形成された帯電防止層 (68, 86, 136) を備えているカバーテープ。

38. 請求項36に記載のカバーテープにおいて、

前記ベースフィルムの第1の面は、中央領域を画定する一対のエッジ領域 (52, 54, 76, 78, 106) を備えているカバーテープ。

39. 請求項38に記載のカバーテープにおいて、

前記ストライプ状の接着剤層は、製品目視領域 (56, 142) を画定する複数の接着剤ストライプ (64, 84, 134, 140) を備えているカバーテープ。

40. 請求項39に記載のカバーテープにおいて、

前記複数の接着剤ストライプ (64, 84, 134, 140) は、少なくとも前記担体テープ区画室の幅の距離だけ隔置されているカバーテープ。

4 1. 請求項4 0に記載のカバーテープにおいて、

前記複数の接着剤ストライプは、前記エッジ領域に位置決めされた一対のエッジストライプ(1 3 4)と、前記中央領域に位置決めされた少なくとも1つのブリッジストライプ(1 4 0)とを備えているカバーテープ。

4 2. 請求項3 6に記載のカバーテープにおいて、

前記ベースフィルム層(5 0, 7 0, 1 2 2)は、前記第1の面に被覆された下地材層(6 2, 8 2, 1 2 8)を備えているカバーテープ。

4 3. 請求項3 6に記載のカバーテープにおいて、

前記ストライプ状の接着剤層は、前記接着剤層に分配された充填材料を備えているカバーテープ。

4 4. カバーテープ(1 2, 1 2 0)を形成するための方法であって、

第1の面と、第2の面と、幅とを有するベースフィルム層(5 0, 7 0, 1 2 2)を提供するステップと、

前記ベースフィルム層の前記第1の面に、ストライプ状の接着剤層(6 4, 8 4, 1 3 4, 1 4 0)を加えるステップと、

前記ストライプ状の接着剤層と前記ベースフィルム層とに第1の帯電防止層(6 6)を形成して、前記ベースフィルム層の前記第1の面のほぼ全体の幅に帯電防止コーティングを設けるステップとを備えている方法。

4 5. 請求項4 4に記載の方法において、

さらに、前記ベースフィルム層の第2の面に帯電防止層を加えるステップを備えている方法。

4 6. カバーテープ(1 2, 1 2 0)を形成するための方法であって、

第1の面と、第2の面と、幅とを有するベースフィルム層(5 0, 7 0, 1 2 2)を提供するステップと、

前記ベースフィルム層の前記第1の面に、下地材層(6 2, 8 2, 1 2 8)を加えるステップとを備えており、前記下地材層は、前記ベースフィルム層の前記第1の面のほぼ全体の幅に帯電防止保護部分を設けることができるように、帯電防止物質を含んでおり、

前記方法は、また、

前記下地材層に、ストライプ状の接着剤層 (64, 84, 134, 140) を形成するステップを備えている方法。

47. 請求項46に記載の方法において、

さらに、前記ベースフィルム層の第2の面に帯電防止層 (68, 86, 136) を加えるステップを備えている方法。

48. カバーテープ (12, 120) を形成するための方法であって、

中央領域を画定する一対のエッジ領域 (52, 54, 76, 78, 106) を有する第1の面と、第2の面と、幅とを有するベースフィルム層 (50, 70, 122) を提供するステップと、

前記エッジ領域にストライプ状の接着剤層 (64, 84, 134) を形成するステップと、

前記接着剤層と前記ベースフィルム層とに第1の帯電防止層 (66) を形成して、前記ベースフィルムの前記第1の面のほぼ全体の幅に帯電防止コーティングを設けるステップとを備えている方法。

49. 請求項48に記載の方法において、

前記ベースフィルム層の前記第2の面に帯電防止層 (68, 86, 136) を加えるステップをさらに含む方法。

50. カバーテープ (12, 120) を形成するための方法であって、

中央領域を画定する一対のエッジ領域 (52, 54, 76, 78, 106) を有する第1の面と、第2の面と、幅とを有するベースフィルム層 (50, 70, 122) を提供するステップと、

前記ベースフィルム層の前記第1の面に、下地材層 (62, 82, 128) を被覆するステップとを備えており、前記下地材層は、前記ベースフィルムの前記第1の面のほぼ全体の幅に帯電防止保護部分を設けることができるように、帯電防止物質を含んでおり、

前記方法は、また、

前記下地材層に、ストライプ状の接着剤層 (64, 84, 134, 140) を形成するステップを備えている方法。

51. 請求項50に記載の方法において、

前記ベースフィルム層の前記第2の面に帯電防止層(68, 86, 136)を加えるステップをさらに含む方法。

52. カバーテープ(12, 120)であって、

第1の面と、該第1の面上に設けられた金属化されたフィルム層とを有するベースフィルム層(50, 70, 122)と、

前記金属化された層に形成されたストライプ状の接着剤層(68, 84, 134, 140)と、

を含むカバーテープ。』

(2) 明細書の第15頁第17行目の記載「区画室92」を『区画室96』に訂正する。

(3) 明細書の第7頁の下から2行目ないし同第8頁第1行目の記載「図9A・
・・端面図。」を削除する。

(4) 明細書の下記該当個所の文言を削除する。

頁	行	削除文言
10	15	(図9Aを参照)
13	19	150
13	21	150
13	23	(図9Aを参照)
15	17	150
15	18	(図9Bを参照)
15	21	150
18	16	160
18	16	162
18	16-17	162
18	17	166
18	17	164
18	17	168
18	18	164
18	18	170

1 8	1 9	1 6 4
1 8	1 9	1 6 8
1 8	2 0	1 6 2
1 8	2 0	1 7 2
1 8	2 0	1 7 4
1 8	2 1	1 7 4
1 8	2 3	1 6 4
1 8	2 5	1 6 2
1 8	2 6	1 6 4
1 8	2 9	1 7 0
1 8	2 9	1 6 8
1 8	2 9	1 6 2
1 9	1	1 7 4
1 9	3	1 6 2
1 9	3	1 6 6
1 9	4	1 7 0
1 9	8	1 6 4
1 9	8	1 6 4

(5) 明細書の第18頁第13行目ないし同第19頁第12行目の記載を下記の通りに訂正する。

『本発明による第4の実施例を説明する。この実施例は、金属化ないし金属被覆したフィルム層を使用し、静電気の破壊を行い、工業規格の要求を達成している。

カバーテープは、ベースフィルム層と、該ベースフィルム層の第1の表面上の金属化層とを含んでいる。下地材層を金属化層上に配置してもよい。この場合、接着剤ストライプは、金属化層上または下地材層上のいずれかに位置づけられる。ベースフィルム層の第2の表面は、付加的なコーティング層を有していてもよい。この付加的なコーティング層は、帯電防止材料や、付加的な金属化フィルム層であってもよい。

この実施例においては、金属化層は、金属化されたフィルムでもよいし、スパッタ・コーティングにより金属を分散させたものでもよい。典型的には、金属化フィルムを、真空吸着方法によりベースフィルム層上に位置づける。これは公知の技法である。金属化フィルム層は、金属フィルムを含むものでもよいし、アルミニウム、銅または他の適当な金属のパーティクル（破片、粉末）を含むものであってもよい。

接着剤、下地材、ベースフィルムおよび付加的なフィルム層上の静電気物質として使用される材料は、先に述べた実施例にて言及した材料と同様のものとして使用することができる。このように、この実施例の一つの利点は、ベースフィルムの第1の表面上に帯電防止材料を設ける必要をなくすることができることにある。さらに、ストライプ状の接着剤がエッジ領域に位置づけられたことにより、先の実施例で述べたような付加的な利点得られる。その利点には、製品上方に接着剤を位置づけないですむことや、他の金属化フィルムに対して改善された製品目視領域を提供することができる点などがある。このように、金属化フィルム層は、担体テープと協働したとき、静電気放電環境を提供する。当業者には理解されるように、金属化フィルム層は、先に述べた実施例とともに様々な態様で組み合わせて使用することができるし、また、これら実施例の組み合わせのすべては、添付した請求の範囲における本発明の範囲に属する。』

以 上